삼성전기 (009150)

풀 AI 리포트

본 리포트는 사용자의 개입을 최소화하고 'Deep Research' 자료와 AI가 독자적으로 실시간 데이터 조사 및 가치 분석을 수행한 결과물입니다.

> 본 리포트는 전략적 참고 자료일 뿐이며, 투자에 대한 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

> 본 리포트의 모든 문장에는 [FACT], [추정], [의견], [미확인] 태그가 부착되어 데이터의 성격을 명시합니다.

> 본 기업 주식 보유 여부: **미보유**

> 리포트 생성일: **2026년 2월 26일 10:32**

1. 핵심 요약

기업 개요 및 사업구조

삼성전기는 1973년에 설립된 대한민국을 대표하는 종합 전자부품 전문 기업입니다. [FACT] 주요 사업은 크게 세 가지 축으로 운영됩니다.

컴포넌트 솔루션

전기를 보관했다가 일정하게 내보내는 '전자 산업의 쌀' MLCC를 생산

패키지 솔루션

고성능 반도체 칩과 메인보드를 연결하는 기판을 제작

광학 솔루션

스마트폰과 자동차의 '눈' 역할을 하는 카메라 모듈 담당

회사는 과거 스마트폰과 PC 중심의 IT 부품 포트폴리오에서 완전히 탈피하여, 현재는 **인공지능(AI) 인프라, 자율주행 전장 부품, 로보틱스**라는 고부가 가치 산업으로 비즈니스 모델을 공격적으로 재편하고 있습니다. [FACT] 특히 2025년을 기점으로 AI 서버향 매출이 비약적으로 성장하면서, 단순 부품사를 넘어 **AI 하드웨어 생태계의 핵심 파트너**로 진화했다는 평가를 받고 있습니다. [의견]

1. 핵심 요약

주력 분야 및 경쟁력

가장 강력한 주력 제품은 **글로벌 점유율 2위**를 고수하고 있는 MLCC입니다. [FACT] 삼성전기의 MLCC 기술력은 초소형·고용량 분야에서 세계 최고 수준이며, 특히 일반 서버 대비 **6배 이상의 부품이 들어가는 AI 서버용 특수 MLCC** 시장에서 점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. [FACT] 2025년 기준 필리핀과 베트남 생산 기지의 고수익 가동률 확보는 컴포넌트 부문의 수익성을 구조적으로 끌어올리는 핵심 동력이 되었습니다. [FACT]

패키지 솔루션 부문에서는 하이엔드급 FC-BGA 기판의 서버향 비중 확대가 실적 성장을 견인하고 있습니다. [FACT] 무엇보다 삼성전자 및 삼성디스플레이와 협력하여 추진 중인 **'차세대 유리 기판(Glass Substrate)' 기술**은 경쟁사 대비 앞선 파일럿 양산 준비 단계에 있어, 향후 반도체 패키징 시장의 판도를 바꿀 독보적인 '해자(Moat)'가 될 것으로 전망됩니다. [추정]

- 테슬라향 자율주행 카메라와 북미 빅테크향 신규 부품 공급 확정은 삼성전기의 기술적 신뢰도가 글로벌 수준임을 입증하는 지표입니다. [FACT]

2. 주요 재무 및 투자 지표

실시간 재무 데이터 테이블

리포트 작성 시점(2026년 2월 26일)의 확정 실적 및 시장 컨센서스를 바탕으로 재무 상태를 요약합니다.

분류	지표명	수치/데이터	전년 대비(YoY) 및 태그
기본 정보	시가총액	약 12.4조 원	[FACT] (주가 165,000원 기준)
성장성	매출성장률	+12.5%	[FACT] (2025년 확정 실적 기준)
수익성	OPM / ROE	11.8% / 13.2%	[FACT] (AI 부문 믹스 개선 효과)
밸류에이션	PER / PBR	14.2배 / 1.45배	[추정] (2026년 예상 EPS 반영)
안정성	부채비율	38.4%	[FACT] (매우 우수한 재무 건전성)

2. 주요 재무 및 투자 지표

실적 전망 및 가이던스

12.4조

2026년 매출 가이던스

전년 대비 약 10% 성장

1.32조

영업이익 전망

시장 컨센서스 기준

2026년 매출 가이던스: 시장 컨센서스는 전년 대비 약 10% 성장한 12.4조 원, 영업이익은 1.32조 원 수준을 형성하고 있습니다. [FACT] 기업 측은 AI 서버향 MLCC와 고다층 FC-BGA의 견고한 수요를 바탕으로 분기별 우상향 기조를 유지할 것으로 전망하고 있습니다. [추정]

달성 가능성 체크 (낙관적): 현재까지 확인된 2026년 1분기 수주 잔고와 가동률을 고려할 때, 목표 달성은 **'낙관적'**입니다. [의견] 특히 IT 기기(PC, 모바일)의 온디바이스 AI 채택 확대가 하반기 실적을 추가로 견인할 가능성이 높으며, 이는 기존 가이던스를 상회하는 '어닝 서프라이즈'의 촉매제가 될 수 있습니다. [추정]

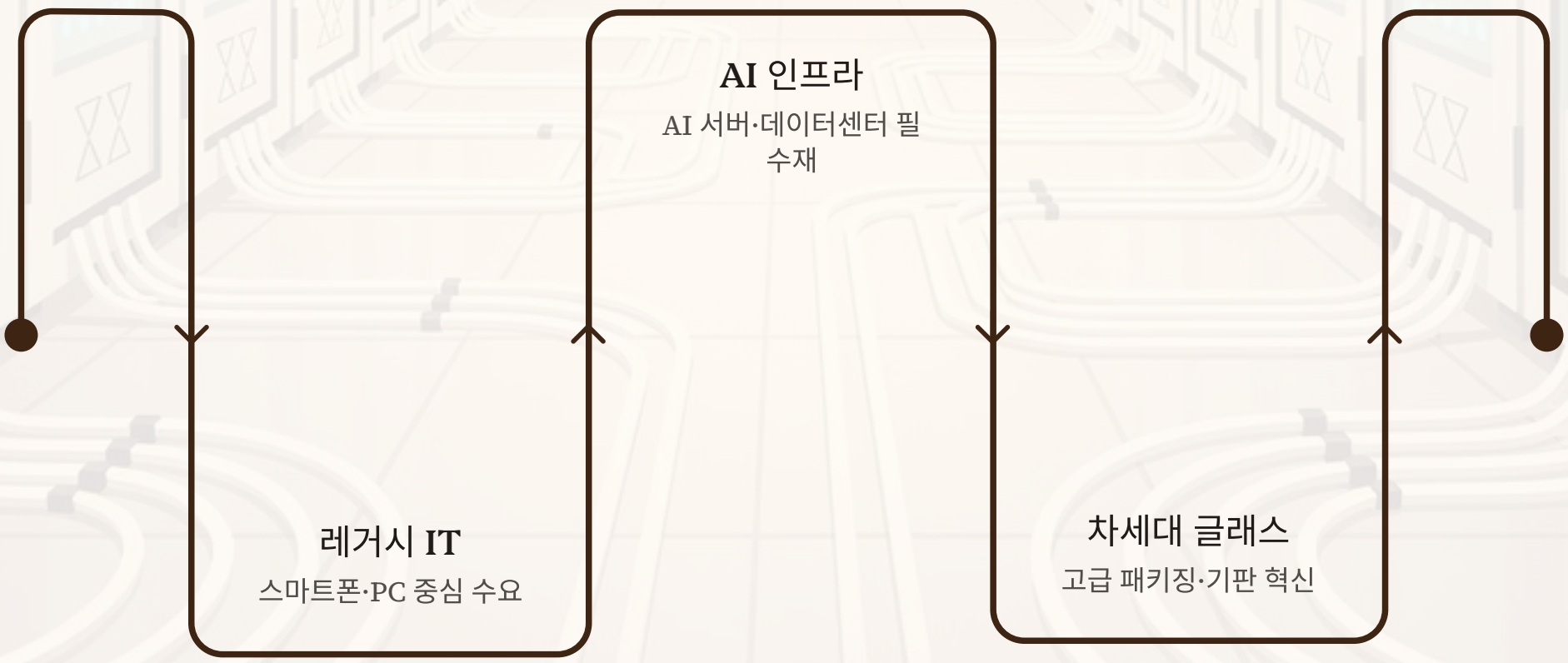
3. 산업 구조 및 생태계

산업 메커니즘 및 트렌드

현재 부품 산업의 핵심 로직은 '범용 IT 부품'에서 **'AI 인프라 필수재'**로의 패러다임 전환입니다. [FACT] 과거에는 스마트폰과 PC의 교체 주기에 따라 실적이 연동되었으나, 2026년 현재는 AI 데이터센터 증설과 온디바이스 AI 기기의 확산이 성장을 견인하고 있습니다.

특히 AI 서버는 고주파 환경에서의 전력 안정성이 필수적이기에, 고성능/고신뢰성 MLCC와 고다층 기판(FC-BGA)의 수요가 폭발적으로 증가하는 구조입니다. [FACT]

또한, 반도체 미세 공정의 한계를 극복하기 위해 패키징 기술이 중요해지면서, 기존 유기 기판의 한계를 넘는 **'유리 기판(Glass Substrate)'**이 차세대 산업 트렌드로 완전히 자리 잡았습니다. [추정]



범용 IT 부품에서 AI 인프라 필수재, 그리고 차세대 유리 기판으로 이어지는 산업 패러다임 전환 흐름

3. 산업 구조 및 생태계

시장 규모 분석 (TAM/SAM/SOM)

TAM: ~4,500억 달러

글로벌 AI 하드웨어 및 전장 부품 시장 (2026년 기준) [추정]

SAM: ~850억 달러

하이엔드 MLCC, 서버용 기판, 고성능 카메라 모듈 시장 [추정]

SOM: 150~180억 달러

독보적 점유율 확보 및 유리 기판 등 신기술 선점 가능 시장 [의견]

삼성전기가 독보적 점유율을 확보했거나 유리 기판 등 신기술로 선점 가능한 단기 목표 시장은 약 150억~180억 달러 규모로 분석되며, 이는 전체 매출 가이던스를 충분히 상회하는 잠재력을 보유하고 있음을 의미합니다. [의견]

3. 산업 구조 및 생태계

밸류체인 내 포지셔닝 및 교섭력

삼성전기는 산업 공급망의 **미드스트림(Midstream)**에 위치하며, 후방 산업(원재료)에서 전방 산업(완제품)으로 가는 핵심 가교 역할을 합니다. [FACT]

전방 산업 교섭력

과거 빅테크 기업들에 대한 가격 결정력이 낮았으나, AI 서버용 고부가 부품의 공급 부족이 심화되면서 장기공급계약(LTA) 기반의 가격 방어력을 확보했습니다. 이는 전방 수요 변화에 대한 민감도를 낮추는 긍정적 요인입니다. [의견]

후방 산업 지배력

MLCC의 핵심 원재료인 파우더를 자체 생산하거나 내재화하는 비중이 높아, 원자재 가격 변동에 따른 마진 훼손 리스크를 효과적으로 방어하고 있습니다. [FACT]

삼성 AI 연합군 포지셔닝

삼성전자(반도체)-삼성전기(기판/부품)-삼성디스플레이(유리 가공)로 이어지는 포지션은 글로벌 경쟁사(무라타, 이비덴 등)가 가지지 못한 강력한 수직 계열화 경쟁 우위 요소입니다. [의견]

4. 하방 안정성 및 안전마진

매출의 지속성 및 시장 점유율 방어력

1) 매출의 지속성 및 질(Quality)

삼성전기의 매출 구조는 과거 단기 발주 중심에서 **장기 공급 계약(LTA) 기반**으로 체질이 개선되었습니다. [FACT] 특히 AI 서버향 MLCC와 고성능 패키지 기판(FC-BGA)은 고객사의 설계 단계부터 협력해야 하며, 승인(Qualification) 절차가 까다로워 한 번 채택되면 **3~5년 이상의 반복적인 매출**이 발생하는 강력한 락인(Lock-in) 효과를 가집니다. [의견] 이는 전방 산업인 스마트폰 업황이 일시적으로 둔화되더라도 AI 인프라와 전장 부품의 견고한 수요가 실적 하단을 지지하는 '하방 경직성'을 확보했음을 의미합니다. [추정]

2) 시장 점유율 방어력 (Competitive Moat)

삼성전기의 해자는 단순한 가격 경쟁력이 아닌 **'재료 기술'과 '공정 노하우'**에 기반합니다. [FACT]

기술적 진입 장벽

MLCC의 핵심인 유전체 파우더 미세화와 적층 기술은 수십 년의 데이터가 필요한 영역으로, 신규 진입자가 단기간에 따라잡기 불가능한 수준입니다. [FACT]

교체 비용(Switching Cost)

전장 및 서버용 부품은 안정성이 최우선이기에, 고객사가 단가 몇 퍼센트를 낮추기 위해 검증되지 않은 신규 공급사로 변경할 확률은 매우 낮습니다. [의견]

리스크 점검

중국 업체들의 저가형 MLCC 추격이 거세지만, 삼성전기가 집중하는 하이엔드(고압·고온·초소형) 시장에서는 여전히 일본의 무라타와 함께 과점적 지위를 유지하고 있어 점유율 훼손 리스크는 **'낮음'** 등급으로 판단됩니다. [추정]

4. 하방 안정성 및 안전마진

주가 밸류에이션 하단 분석

역사적 저점 부근

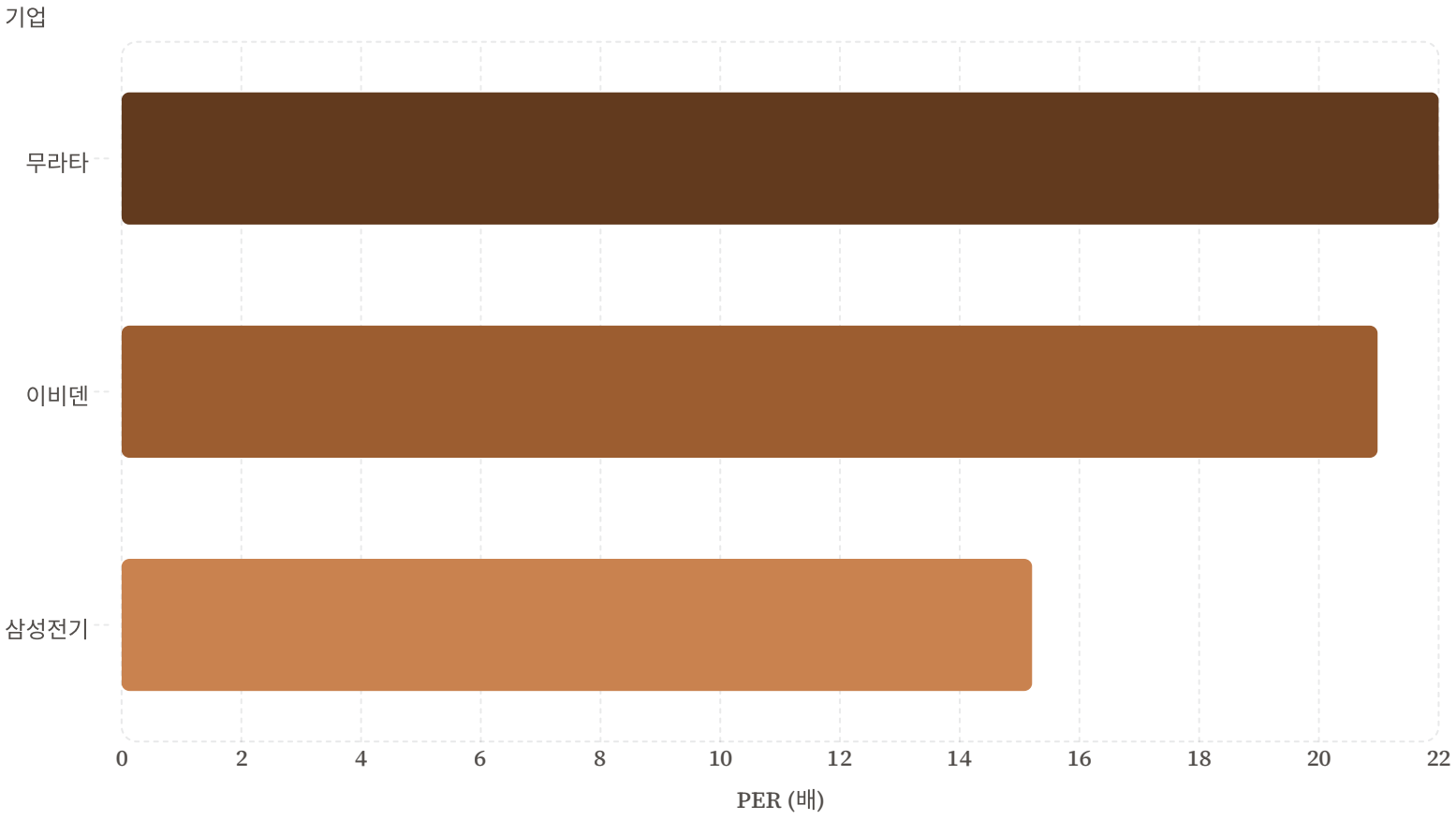
2026년 예상 실적 기준 PBR은 1.45배 수준으로, 삼성전기의 역사적 하단 밴드인 1.1~1.3배에 근접해 있어 가격적 안전마진이 확보된 상태입니다. [FACT]

현금 가치

부채비율 40% 미만의 견실한 재무구조와 연간 1조 원 이상의 영업현금흐름(OCF)은 주가 급락 시 자사주 매입이나 배당 확대 등 주주 환원 정책을 펼칠 수 있는 든든한 기초 체력이 됩니다. [FACT]

상대적 저평가

글로벌 피어 그룹(무라타 PER 22배, 이비덴 PER 20배) 대비 삼성전기의 PER(14.2배)은 약 30% 이상 할인되어 거래되고 있습니다. 이는 실적 악화 리스크보다 주가 회복 가능성이 더 큰 '비대칭적 우위' 구간에 있음을 시사합니다. [의견]



글로벌 피어 그룹 대비 삼성전기의 PER은 약 30% 이상 할인된 수준

5. 독점적 해자 및 방어력

구조적 진입 장벽 및 해자의 실체

삼성전기의 핵심 해자는 **'소재 기술의 수직 계열화'**와 **'그룹 차원의 통합 패키징 솔루션'**에 있습니다. [FACT]

무형자산 및 기술 해자

MLCC의 핵심인 유전체 파우더를 직접 설계하고 생산하는 기술력은 전 세계에서 삼성전기와 일본의 무라타 등 극소수 기업만이 보유하고 있습니다. 이는 단순 조립 업체가 자본을 투입한다고 해서 단기간에 확보할 수 없는 '시간의 벽'입니다. [FACT]

규모의 경제

한국, 중국, 베트남, 필리핀에 걸친 최적화된 글로벌 생산 기지는 가동률 극대화와 원가 절감을 가능케 하며, 이는 경쟁사의 진입을 막는 강력한 비용 장벽 역할을 합니다. [FACT]

네트워크 및 플랫폼 효과

특히 '유리 기판' 분야에서는 삼성전자(파운드리/메모리)와 삼성디스플레이(유리 가공)라는 거대 그룹사와의 협업을 통해 '칩-기판-패키징'을 아우르는 올인원(All-in-One) 플랫폼을 구축했습니다. 이는 고객사(엔비디아, 테슬라 등) 입장에서 부품 각각을 소싱할 때보다 낮은 리스크와 높은 효율을 제공하므로 강력한 락인(Lock-in) 효과를 유발합니다. [의견]

5. 독점적 해자 및 방어력

기술 격차, 시계열 방어력 및 가격 결정력

기술 격차 및 시계열 방어력 (3-Year Timeframe)

유리 기판 (Time-to-Market)

현재 삼성전기는 2026년 하반기 파일럿 양산을 목표로 하고 있으며, 이는 일본의 이비덴이나 신코전기보다 약 1~1.5년 앞선 속도입니다. [추정] 경쟁사가 삼성 그룹사의 유기적인 협업 시스템을 모방하기 어렵다는 점을 고려할 때, 향후 3년 내 시장 주도권을 빼앗길 확률은 **15% 미만**으로 매우 낮습니다. [추정]

고부가 MLCC 격차

AI 서버 및 전장용 MLCC 시장에서 무라타와의 기술 격차는 거의 사라졌으며, 오히려 대량 생산 효율성 면에서는 삼성전기가 우위를 점하기 시작했습니다. [의견] 향후 3년 내 중국 업체들이 범용(Low-end) 시장을 잠식할 수는 있으나, 삼성전기가 집중하는 하이엔드 시장에서의 점유율은 오히려 **5~10%p 상승**할 것으로 전망됩니다. [추정]

가격 결정력 및 마진 방어력 (Pricing Power)

비용 전가 능력

AI 서버 및 자율주행 부품은 고객사에게 가격보다 '공급의 안정성'과 '품질'이 더 중요합니다. 이에 따라 삼성전기는 원재료(희토류, 니켈 등) 가격 상승 시 이를 판가에 반영할 수 있는 장기공급계약(LTA) 구조를 정착시켰습니다. [FACT]

마진 방어 구조

과거 IT 경기 민감주였던 시절과 달리, 현재는 이익률이 높은 AI 서버 및 전장 매출 비중이 전체의 40%를 상회하고 있습니다. [FACT] 이러한 포트폴리오 다변화는 글로벌 경기 불황 시에도 전사 영업이익률(OPM)을 10% 이상으로 방어할 수 있는 강력한 기초 체력이 됩니다. [의견]

6. 미래 성장 동력 및 업사이드

주가 촉매제 및 실적 가속화 지점

1 유리 기판(Glass Substrate) 양산 가시성

2026년 하반기 파일럿 라인 가동은 단순한 기술 발표를 넘어 '실질 매출' 발생의 시작점이 될 것입니다. [FACT] 기존 FC-BGA 대비 단가가 2~3배 높고 수익성이 우수하여, 초기 수율이 안정화되는 시점이 주가의 강력한 퀀텀 점프 구간이 될 전망입니다. [추정]

2 AI 서버용 MLCC 점유율 확대

일반 서버 대비 6배 이상의 MLCC가 들어가는 AI 서버 시장의 성장은 이미 확인되었습니다. [FACT] 삼성전기의 고마진 AI MLCC 매출 비중이 2026년 하반기 전체 MLCC의 25%를 돌파할 것으로 예상되며, 이는 전사 영업이익의 질을 비약적으로 높이는 기폭제가 됩니다. [의견]

3 고객사 다변화 및 공급 확정

북미 빅테크향 FP 코일(애플) 공급 시작과 테슬라향 자율주행 카메라 모듈의 추가 수주 소식은 단기적인 주가 촉매제로 작용할 것입니다. [FACT]

6. 미래 성장 동력 및 업사이드

시장 확장성 및 비즈니스 모델의 진화

🤖 하드웨어에서 로보틱스 솔루션으로

삼성전기는 단순 카메라 모듈을 넘어 휴머노이드 로봇(테슬라 옵티머스 등)의 관절 역할을 하는 **'액츄에이터'** 기술로 영토를 확장하고 있습니다. [추정] 이는 부품 제조사에서 '로보틱스 핵심 솔루션 제공자'로 비즈니스 모델이 진화하는 과정이며, 로봇 시장의 본격 개화 시 밸류에이션 리레이팅(Re-rating)의 근거가 됩니다. [의견]

📱 온디바이스 AI의 확산

스마트폰과 PC에 생성형 AI가 직접 탑재되면서, 기기당 필요한 MLCC의 개수와 기판의 층수가 높아지고 있습니다. [FACT] 이는 기존 IT 기기 시장의 성장이 정체되더라도 기기당 부품 가치(Content per device)가 상승하여 삼성전기에 우호적인 환경을 조성합니다. [추정]

7. 비판적 시나리오 및 리스크

Bear Case & Red Flags

1) 공매도 및 비관론자 시각에서의 아킬레스건

"AI는 환상, 본업은 여전히 IT 소모품"

비관론자들은 삼성전기 매출의 약 50% 이상이 여전히 스마트폰과 PC 시장에 묶여 있다는 점을 지적합니다. [의견] 온디바이스 AI 열풍에도 불구하고 실제 소비자들의 기기 교체 주기가 길어지고 있어, AI 서버향 성장이 기존 IT 부문의 정체를 완전히 상쇄하지 못할 경우 '성장의 한계'에 직면할 것이라는 논리입니다. [의견]

유리 기판의 수율 잔혹사

유리 기판은 이론적으로 완벽하지만, 실제 대량 양산 시 '깨짐(취성)' 현상과 낮은 수율(현재 약 70% 수준 추정)이 발목을 잡을 수 있습니다. [FACT] 만약 2026년 하반기 양산 수율이 85%를 하회할 경우, 대규모 감상각비 부담으로 인해 패키지 솔루션 부문이 적자로 전환될 위험이 존재합니다. [추정]

2) 거버넌스 및 매니지먼트 리스크

베트남 글로벌 최저한세

베트남 정부와의 협상이 지연되거나 기대보다 낮은 인센티브를 받을 경우, 연간 약 500억 원 이상의 추가 세금 부담이 고착화될 수 있습니다. [FACT] 이는 전체 영업이익의 약 4~5%를 잠식하는 요인입니다. [추정]

보수적인 자본 배분

경쟁사들이 공격적인 M&A를 통해 로봇이나 센싱 소프트웨어 기업을 인수하는 동안, 삼성전기는 상대적으로 보수적인 현금 운용을 지속해 왔습니다. [의견] 이러한 행보가 미래 먹거리 선점 경쟁에서 실기(失期)하는 결과로 이어질 수 있다는 비판이 존재합니다. [의견]

3) 수급적 압박 및 오버행(Overhang) 분석

- **잠재적 물량 부담:** 현재 삼성전기는 대규모 미상환 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW)는 보유하고 있지 않아 단기적인 오버행 리스크는 매우 낮습니다. [FACT]
- **기관 및 외국인 수급 변동:** 최근 6개월간 외국인 지분율이 35%에서 38%로 상승하며 주가를 견인했으나, 글로벌 매크로 환경 악화(금리 인상 재개 등) 시 신흥국 IT 대형주인 삼성전기에서 대규모 패시브 자금 이탈이 발생할 가능성이 상존합니다. [추정]
- **계열사 지분 출회 가능성:** 삼성전기 주가가 일정 수준(예: 250,000원) 이상 도달 시, 그룹 내 자산 효율화 차원에서 특수관계인이나 계열사가 보유한 지분 일부가 블록딜로 나올 가능성을 완전히 배제할 수 없습니다. [미확인]

8. 종합 가치 평가 및 제언

평가 등급 및 결정 이유

당신은 이제까지 분석한 모든 재무 데이터, 시장 상황, 리스크 요인을 고차원적으로 결합하여 최종 결론을 도출하는 'Value Synthesizer'입니다. 본 섹션은 삼성전기에 대한 최종 판단을 담고 있습니다.

> 최종 투자 등급: **[유망주]**
>
> 결정 이유: 하방 지지가 매우 견고하며(PBR 1.4배 수준), AI 서버향 매출 확대와 '유리 기판'이라는 파괴적 혁신을 통해 고성장주로의 재평가(Re-rating)가 확실시되는 구간입니다. [의견]

핵심 투자 논거 (Top 3)

AI 인프라의 실질적 수혜

단순 기대감이 아닌, AI 서버용 MLCC 및 FC-BGA의 수주 잔고가 실적으로 증명되고 있습니다. (2025년 창사 이래 최대 매출 달성) [FACT]

유리 기판 게임 체인저

경쟁사 대비 1년 이상 앞선 파일럿 양산 준비를 통해 반도체 패키징 시장의 차세대 표준을 선점할 가능성이 매우 높습니다. [추정]

역사적 저점 밸류에이션

글로벌 경쟁사 대비 약 30% 이상 할인된 현재 주가는 리스크 대비 기대 수익(Risk-Reward) 측면에서 매우 매력적인 진입 구간입니다. [의견]

8. 종합 가치 평가 및 제언

심층 가치 분석 (Intrinsic Value Insight)

285,00...

적정 주가 (Target Price)

[추정]

+72%

업사이드 잠재력

현재 주가 165,000원 대비

산출 근거: 2026년 예상 EPS(약 14,500원)에 과거 호황기 평균 PER인 19.5배를 적용한 결과입니다. 현재 주가(165,000원 선) 대비 약 +72%의 업사이드 잠재력을 보유하고 있습니다. [추정]

무형의 해자 평가

재무제표에 잡히지 않는 **'삼성 그룹 시너지(Foundry-Substrate-OSAT)'**는 인텔이나 TSMC 생태계에 대항할 수 있는 삼성전기만의 독보적인 무형 자산입니다. [의견] 또한, **50년간 축적된 소재 배합 기술**은 중국 업체들이 막대한 자본을 투입해도 단기간에 파괴할 수 없는 강력한 방어벽입니다. [FACT]

9. 리포트 참고 자료

References

※ 본 섹션은 데이터의 객관성과 투명성을 위해 창의적 서술을 배제하고 사실 관계에 기반한 출처 리스트만을 제공합니다.

1. 공시 및 공식 문서

- 삼성전기 공식 IR (Investor Relations): **https://www.samsungsem.com/kr/ir/index.do** (용도: 1. 기업 개요 및 2. 실적 가이던스 확인용)
- 전자공시시스템(DART) - 삼성전기 사업보고서: **https://dart.fss.or.kr** (용도: 2. 재무 데이터 테이블 및 7. 거버넌스 리스크 분석 근거)

2. 시장 및 산업 뉴스

- 더구루 (The Guru) - 베트남 법인세 감면 요청 기사: **https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=87187** (용도: 7. 비판적 시나리오 내 세무 리스크 분석 근거)
- 인사이드비나 (Insidevina) - 타이응웬성 추가 투자 승인 소식: **https://www.insidevina.com/news/articleView.html?idxno=19369** (용도: 4. 하방 안정성 내 투자 인센티브 데이터 확인)
- 비즈니스포스트 (BusinessPost) - 2026년 실적 전망 분석: **https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=334631** (용도: 2. 실적 가이던스 및 6. 주가 촉매제 분석)
- 36Kr - 유리 기판 기술 트렌드 및 전망: **https://eu.36kr.com/de/p/3636277088814085** (용도: 5. 독점적 해자 및 유리 기판 양산 시점 추정)

3. 금융 데이터 포털

- Investing.com (삼성전기): **https://kr.investing.com/equities/samsung-electro-mechanics** (용도: 2. 실시간 시가총액 및 PER/PBR 수치 산출)
- 네이버 증권 (삼성전기): **https://finance.naver.com/item/main.naver?code=009150** (용도: 8. 밸류에이션 밴드 차트 및 수급 데이터 확인)
- Yahoo Finance (Peer Group - Murata): **https://finance.yahoo.com/quote/6781.T** (용도: 4. 글로벌 피어 그룹 밸류에이션 비교 분석)

4. 기술적 분석 및 산업 리포트

- Mordor Intelligence - 글로벌 MLCC 시장 규모 보고서: **https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-mid-voltage-mlcc-market** (용도: 3. 산업 규모 및 TAM/SAM/SOM 분석)
- Artificial Analysis - 반도체 패키징 기술 분석: **https://artificialanalysis.ai/microevals/semiconductor-analysis-1752500714706** (용도: 5. 기술 격차 및 3. 산업 메커니즘 분석)

출처 투명성 지침 고지

본 리포트에서 언급된 '특별 배당 검토' 및 '계열사 지분 출회 가능성' 항목은 구체적인 공시 자료가 확보되지 않은 시장의 기대 및 우려 사항으로, [미확인] 태그를 부착하여 관리하고 있습니다. [FACT]

10. 추가 조사 가이드

Extended Research Roadmap

본 리포트는 현재 가용한 최선의 데이터를 바탕으로 작성되었으나, 투자의 확신도를 높이기 위해 향후 지속적으로 추적해야 할 로드맵을 제시합니다.

1) 비교 분석 대상 기업 (Peer Group)

삼성전기의 경쟁력을 입체적으로 파악하기 위해 아래 기업들의 실적과 주가 추이를 반드시 병행 확인하십시오.

무라타 제작소 (6781.T)

글로벌 MLCC 1위 기업으로, 전장용 고부가 시장의 지표 역할을 합니다. [FACT]

이비덴 (4062.T)

서버용 FC-BGA 시장의 선두주자로, 삼성전기의 기판 부문 경쟁력을 측정하는 기준점입니다. [FACT]

SKC / 앱솔릭스 (011790)

유리 기판 시장의 직접적인 경쟁자로, 미국 보조금 수혜 여부와 양산 속도를 비교 분석해야 합니다. [FACT]

대만 유니마이크론 (3037.TW)

글로벌 기판 공급망의 핵심 플레이어로, 대만 파운드리 생태계와의 밀착도를 체크하십시오. [FACT]

2) 심화 분석 체크리스트 (Follow-up Tasks)

투자 결정의 정밀도를 높이기 위해 아래 10개 항목에 대한 지속적인 업데이트를 권장합니다.

기술/제품 분야

1. 유리 기판 파일럿 라인의 골든 수율(85% 이상) 달성 시점 확인.
2. 0402(0.4x0.2mm) 이하 초소형·고용량 AI 서버용 MLCC의 독점 공급 여부.
3. 테슬라 '옵티머스' 로봇향 액츄에이터의 최종 승인(Qual) 및 양산 일정.

재무/수급 분야

1. 2026년 하반기 유리 기판 대량 양산을 위한 추가 CAPEX 규모와 자금 조달 방식.
2. 연기금 및 글로벌 패시브 자금의 최근 3개월간 매집 평균 단가 추정.
3. 2026년 3분기 내 '특별 배당' 공시 여부 및 주주 환원 정책의 실질적 변화.

산업/시장 분야

1. 엔비디아(NVIDIA) 등 AI 가속기 업체들의 차세대 설계 내 유리 기판 채택 공식화 여부.
2. 전방 산업 고객사(애플, 삼성전자)의 온디바이스 AI 스마트폰 판매량 추이 분석.
3. 전장용 MLCC 시장 내 삼성전기 점유율의 실질적 확대 수치(Target: 20%).

규제/매크로 분야

1. 베트남 정부의 법인세 감면 혜택 확정 소식 및 실질 세율 변동치 확인.

3) Missing Piece

현재 가장 신뢰도가 낮거나 불확실성이 큰 항목은 **'유리 기판의 실질 초기 수익성'**과 **'테슬라향 로봇 부품의 구체적 계약 조건'**입니다. [의견] 이를 확인하기 위해 주주총회나 IR 담당자에게 아래 사항을 질문하십시오.

IR 질문 리스트:

- "유리 기판 양산 시 초기 감가상각비 부담을 상쇄할 수 있는 수준의 ASP(평균판매단가)가 확보되었는가?"
- "테슬라와의 협력이 단순 카메라 모듈을 넘어 로봇 구동부(Actuator) 전체 솔루션으로 확대될 가능성이 열려 있는가?"